

## 「電子材料事業部、2009 年中国半導体協会セミナーに参加」

電気化学工業株式会社  
電子材料事業部

当社電子材料事業部は、2009 年 6 月 10 日～11 日の 2 日間にわたり、中国江蘇省無錫市のラディソンプラザホテルにて開催された、中国半導体協会主催「第 7 回中国半導体包装技術セミナー（中国半導体協会セミナー）」へ初参加しました。

当セミナーは中国半導体協会及び市政府が主催する半導体産業の全国規模を誇る大会で、今年は無錫市で開催されました。半導体協会と主要研究機関の関係者、中国内外の半導体関連企業約 200 社が参加し、直近の中国半導体産業の報告や様々な先端技術についての発表が行われました。

当社は上海市半導体協会の推薦を得て特別支援社として参加しました。発表報告では当社の事業紹介と電子材料製品のプレゼンテーションを行い、会場に設置した展示ブースでは、当社の主要電子材料製品を展示しました。

成長を続ける機能的なダイシングテープ「エレグリップ」、世界トップシェアを持つ、半導体と電子部品の搬送材料「キャリアテープ用シート（EC シート、CST シート）」「デンカサーモフィルム ALS」、半導体封止材用フィラーとして世界トップシェアを誇る「熔融シリカ」や、「球状アルミナ」を展示しました。

また最近、優れた省エネルギー技術で注目を浴びている、LED 向け放熱部材「HITT PLATE」 「デンカ放熱シート」についても、パネル展示をいたしました。

中国半導体業界各社の幹部や技術者など多数の方々が、発表会や当社ブースへおいでになり、当社の電子材料製品への高い関心と熱い期待を寄せていただきました。

中国では、国を挙げて半導体産業を強化しており、半導体製造各社では高付加価値の半導体（12 インチ）製造ラインの新增設が進んでいます。当社は半導体材料や電子材料メーカーとして、今後もこのような貴重な機会を通じて半導体業界の方々との交流を深めながら、中国半導体産業の発展に、一層の貢献することを目指して参ります。

ご照会先： 電子材料事業部 事業企画部 電話 03-5290-5540

(写真資料)



会社概況説明風景 対馬テープ・接着剤部長 (左)、上海 MEDIC 周総経理 (右)



活気あるセミナー風景



電気化学工業 ブース風景



中国半導体協会長 (右) との歓談



長虹電子・王董事長 (右) との歓談